

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60191-2

AMENDEMENT 15
AMENDMENT 15
2006-07

Amendement 15

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

**Partie 2:
Dimensions**

Amendment 15

**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

**Part 2:
Dimensions**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
Publication 60191-2*

*The sheets contained in this amendment are to be
inserted in Publication 60191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

F

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

[IECNORM.COM](#) : Click to view the full PDF of IEC 60191-2:1966/AMD15:2006

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2**

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface à l'amendement 14 (2006).

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

60191 IEC I-179E - a/b/c/d/e.

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2**

Replace the existing title page with the new title page.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to Amendment 14 (2006).

Chapter I:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-179E - a/b/c/d/e.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60191-2:1966/AMD15:2006

[IECNORM.COM](#) : Click to view the full PDF of IEC 60191-2:1966/AMD15:2006

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60191-2

Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976), G (1978), H (1978),
J (1980), K (1981), L (1982), M (1983), N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995),
S (1995), T(1995), U(1997), V(1998), W(1999), X(1999), Y(2000), Z(2000)
et/and Amendement/Amendment 1 (2001), 2(2001), 3(2001), 4(2001),
5(2002), 6(2002), 7(2002), 8(2003), 9(2003), 10(2004), 11(2004), 12(2006),
13(2006), 14(2006), 15(2006)

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –

Partie 2: Dimensions

Mechanical standardization of semiconductor devices –

Part 2: Dimensions

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60191-2-1966/AMENDMENT 15

Aucune partie de cette publication ne peut être
reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce
soit et par aucun procédé, électronique ou
mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or
utilized in any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopying and
microfilm, without permission in writing from the
publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

[IECNORM.COM](#) : Click to view the full PDF of IEC 60191-2:1966/AMD15:2006

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

NORMALISATION MÉCANIQUE
DES DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

PRÉFACE

CONCEPTION DE LA NORMALISATION
MÉCANIQUE Chapitre 00

VALEURS RECOMMANDÉES POUR CERTAINES DIMENSIONS DE DESSINS DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS Chapitre 0

DESSINS D'ENCOMBREMENTS Chapitre I

TYPES DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS GÉNÉRALEMENT MONTÉS DANS LES BOÎTIERS DU CHAPITRE I

DESSINS D'EMBASES Chapitre II

DESSINS DE BOÎTIERS Chapitre III

DESSINS DE CALIBRES Chapitre IV

TABLEAUX MONTRANT LES ASSOCIATIONS ENTRE LES BOÎTIERS ET LES EMBASES Chapitre V

DESSINS OBSOLESDES

COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DES NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

SUPPRESSIONS DANS LES LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DES NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD

PREFACE

PHILOSOPHY OF MECHANICAL STANDARDIZATION Chapter 00

RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF SEMICONDUCTOR DEVICES Chapter 0

DEVICE OUTLINE DRAWINGS Chapter I

TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES GENERALLY MOUNTED IN THE PACKAGES OF CHAPTER I

BASE DRAWINGS Chapter II

CASE OUTLINE DRAWINGS Chapter III

GAUGE DRAWINGS Chapter IV

TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BETWEEN CASE OUTLINES AND BASES Chapter V

OBSOLETE DRAWINGS

ADDITIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2

DELETIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Amendement 15 (2006) à la CEI 60191-2 (1966)

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 2: Dimensions

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

PRÉFACE À L'AMENDEMENT 15 (2006)

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/651/FDIS	47D/659/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Amendment 15 (2006) to IEC 60191-2 (1966)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 2: Dimensions

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

PREFACE TO AMENDMENT 15 (2006)

This amendment has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/651/FDIS	47D/659/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

[IECNORM.COM](#) : Click to view the full PDF of IEC 60191-2:1966/AMD15:2006

CHAPITRE 00 – CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE

1. Règles fondamentales

Lors de la réunion tenue à Montreux (juin 1981), le Comité d'Etudes n° 47 adopta les règles fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées à Copenhague en octobre 1962:

- A. Toute proposition nouvelle devra être soumise à l'étude préliminaire d'un groupe de travail convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.
- B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs suivants:
 - 1. Aboutir à une normalisation active en n'acceptant que les boîtiers qui sont soutenus internationalement.
 - 2. Spécifier de façon précise les dimensions en vue d'assurer l'interchangeabilité et de faciliter les manipulations automatiques.
 - 3. Reconsidérer continuellement les dessins existants et proposer la suppression de ceux qui ne sont plus soutenus.
- C. Il ne sera procédé à la discussion d'un dessin de boîtier que s'il a le soutien préalable d'au moins trois pays.
- D. Un dessin ne sera introduit dans la Publication 191-2 de la CEI que si au moins trois des pays qui le soutiennent ont fourni leur numéro de code national (ou exprimé un soutien formel s'ils ne possèdent pas de numéro de code).

Notes 1. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Orlando (février 1980), il a été admis d'étendre le domaine d'activité du GT7 de façon qu'il couvre aussi bien la normalisation mécanique des semiconducteurs discrets que celle des circuits intégrés.

Il a été également admis que, compte tenu de l'élargissement de son domaine d'activité, le GT7 serait le groupe de travail qualifié mentionné dans le paragraphe A.

En vue d'éviter que l'introduction du GT7 dans le processus suivi par le Comité d'Etudes n° 47 pour préparer des documents secrétariat sur la normalisation mécanique provoque des délais supplémentaires, le GT7 a été autorisé à obtenir de la part des trois pays concernés, ou plus, la confirmation directe du maintien de leur appui pour ces propositions.

2. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Montreux (juin 1981), il a été admis que les réunions du GT7 s'intégreraient dans les réunions du Comité d'Etudes n° 47.

Cependant, certaines propositions peuvent nécessiter un temps d'études dépassant la durée d'une réunion du Comité d'Etudes n° 47 et en conséquence requérir une ou plusieurs réunions du GT7 entre deux réunions consécutives du Comité d'Etudes n° 47.

Lors de la réunion tenue à Moscou (juin 1977), le Comité d'Etudes n° 47 adopta la règle suivante:

Lorsqu'un dessin de la Publication 191-2 de la CEI vient à ne plus être soutenu que par un seul pays, il sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intitulée «Dessins obsolètes» avec l'indication de la date de transfert sur la feuille particulière correspondante.

Un avertissement au début de la section dévolue aux dessins obsolètes stipulera qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf s'il est soutenu par un autre pays dans l'intervalle.

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

Liste des dessins (suite)**List of drawings (continued)**

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	IEC code number	Code of country of origin	Page number and date
116E01	SC-529-14BA	I-116E 1988	116E01	SC-529-14BA	I-116E 1988
116E02	SC-530-16CA		116E02	SC-530-16CA	
116E03	SC-531-20AA		116E03	SC-531-20AA	
117E01	SC-530-16BA		117E01	SC-530-16BA	
117E02	SC-531-20BA		117E02	SC-531-20BA	
117E03	SC-532-24AA	I-117E 1988	117E03	SC-532-24AA	I-117E 1988
117E04	SC-533-28AA		117E04	SC-533-28AA	
117E05	SC-533-28BA		117E05	SC-533-28BA	
118E01	SC-532-24BA	I-118E 1988	118E01	SC-532-24BA	I-118E 1988
118E02	SC-533-28CA		118E02	SC-533-28CA	
119E02	(Etats-Unis)	I-119E 1990	119E02	(USA)	I-119E 1990
119E03			119E03		
120E	NT194	I-120E 1990	120E	NT194	I-120E 1990
121E	NT213	I-121E 1994	121E	NT213	I-121E 1994
122E	NT221	I-122E 1994	122E	NT221	I-122E 1994
123E		I-123E 1997	123E		I-123E 1997
129E	NT223	I-129E 1994	129E	NT223	I-129E 1994
133E		I-133E 2000	133E		I-133E 2000
134E		I-134E 2000	134E		I-134E 2000
135E		I-135E 2000	135E		I-135E 2000
136E		I-136E 2000	136E		I-136E 2000
137E		I-137E 2000	137E		I-137E 2000
138E		I-138E	138E		I-138E
139E		I-139E	139E		I-139E
140E		I-140E 1999	140E		I-140E 1999
141E		I-141E 1999	141E		I-141E 1999
142E		I-142E 1998	142E		I-142E 1998
143E		I-143E 1998	143E		I-143E 1998
144E		I-144E 1999	144E		I-144E 1999
147E		I-147E 1999	147E		I-147E 1999
148E		I-148E 1999	148E		I-148E 1999
149E		I-149E 2000	149E		I-149E 2002
150E		I-150E 2002	150E		I-150E 2002
151E		I-151E 2002	151E		I-151E 2002
152E		I-152E 2002	152E		I-152E 2002
153E		I-153E 2002	153E		I-153E 2002
154E		I-154E 2001	154E		I-154E 2001
155E		I-155E 2001	155E		I-155E 2001
156E		I-156E 2004	156E		I-156E 2004
157E		I-157E 2001	157E		I-157E 2001
158E		I-158E 2002	158E		I-158E 2002
159E		I-159E 2002	159E		I-159E 2002
160E		I-160E 2001	160E		I-160E 2001
161E		I-161E 2001	161E		I-161E 2001
162E		I-162E 2001	162E		I-162E 2001
163E		I-163E 2002	163E		I-163E 2002
164E		I-164E 2001	164E		I-164E 2001
165E		I-165E 2002	165E		I-165E 2002
166E		I-166E 2003	166		I-166E 2003
167E		I-167E 2003	167E		I-167E 2003
168E		I-168E 2004	168E		I-168E 2004
171E		I-171E 2006	171E		I-171E 2006
175E		I-175E 2005	175E		I-175E 2005
176E		I-176E 2004	176E		I-176E 2004
178E		I-178E 2006	178E		I-178E 2006
179E		I-179E 2006	179E		I-179E 2006
Forme F			Form F		
084F		I-084F 1996	084F		I-084F 1996
100F		I-100F 1990	100F		I-100F 1990
101F01	101F01	I-101F 1998	101F01		I-101F 1998
101F01	101F01		101F01		

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
102F			
102F0	102F01	I-102F	1998
102F02	102F02		
102F033	102F03		
Forme G			
050G01	SO5-87D		
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F	I-50a/b/c/d	1985
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SO505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Suède)		
050G16	A1AA		
050G17	A1AB		
050G18	A1BA	I-50e	1990
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)

IEC code number	Code of country of origin	Page number and date
102F		
102F0	102F01	I-102F
102F02	102F02	1998
102F033	102F03	
Form G		
050G01	SO5-87D	
050G02	SO-188D	
050G03	SO-87A	
050G04	SO-87B	
050G05	SO-188A	
050G06	SO-188B	
050G07	SO-188F	I-50a/b/c/d
050G08	SO-87C	1985
050G10	SO-188C	
050G11	SO505-18A	
050G12	SO-87G	
050G13	SO-188E	
050G14	(Sweden)	
050G16	A1AA	
050G17	A1AB	
050G18	A1BA	I-50e
050G19	A1BB	1990
050G20	A1CB	

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60191-2-1966/AMD15:2006

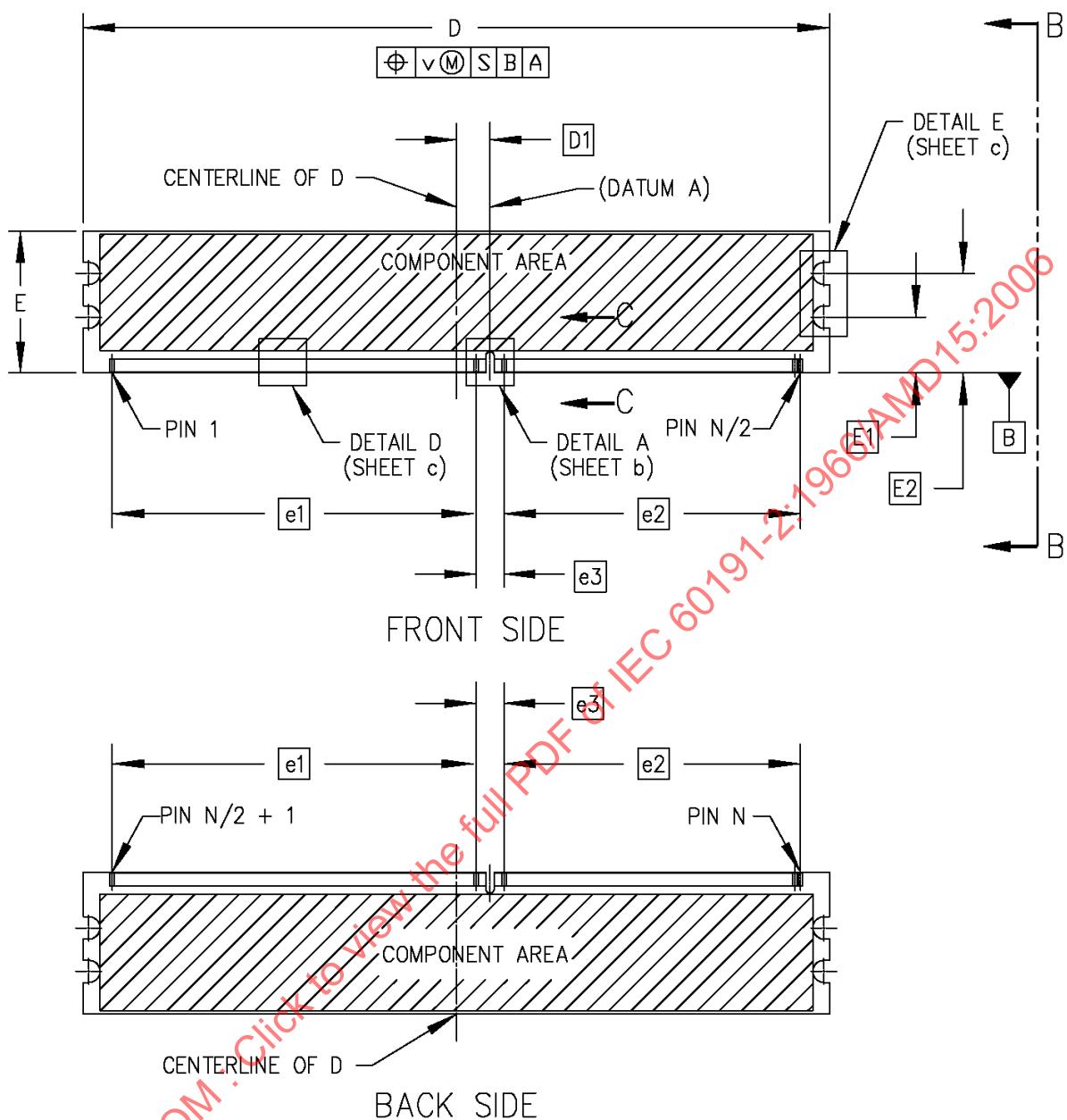
[IECNORM.COM](#) : Click to view the full PDF of IEC 60191-2:1966/AMD15:2006

**Types de dispositifs à semiconducteurs
généralement montés dans les boîtiers
du chapitre I de la CEI 60191-2**

**Types of semiconductor devices
generally mounted in the packages
of chapter I of IEC 60191-2**

Type de dispositif Type of device	Numéro de code CEI du dessin du boîtier IEC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Signal diodes and small-power Zener diodes	A1, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69, A70, A71, 098H, 100H
Diodes hyperfréquences Microwave diodes	A18
Diodes de redressement de faible et moyenne puissance Rectifier diodes, small and medium power	A2, A3, A4, A6, A7, A19, A37, A44, A74, 077B, 100B
Diodes de redressement de forte puissance High-power rectifier diodes	A8, A9, A10, A15, A16, A17, A21, A22, A35, 083B, 103B
Thyristors de faible et moyenne puissance Thyristors, small and medium power	A11, A13, A14, A38, A43
Thyristors de forte puissance High-power thyristors	A12, A27, A28, A29, A34, A39, A47, 104B, 105B
Transistors de signal Signal transistors	A36, A40, A41, 068A, 046E, 114E
Transistors de puissance Power transistors	A23, A30, A31, A43, A48, A56, A57, A45, A73, 080B, 081B, 082B, 101B, 102B, 102F, 120E, 084F, P100F
Transistors hyperfréquences Microwave transistors	A26, A42, A43, A59, A66, A72, 100C
Dispositifs optoélectroniques Optoelectronic devices	A62, A64, A65, A63A, 100A, 101A, 106B, 107B
Circuits intégrés Integrated circuits	A52, A53, A61, 075E, 076E, 099E, 100E, 102E, 112E, 115E, 116E, 117E, 118E, 119E, 121E, 122E, 123E, 129E, 133E, 134E, 135E, 136E, 137E, 138E, 139E, 140E, 141E, 144E, 147E, 148E, 149E, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E, 162E, 163E, 164E, 165E, 166E, 167E, 168E, 171E, 175E, 176E, 178E, 179E, 050G, 051G, 060G, 100G, 101G

[IECNORM.COM](#) : Click to view the full PDF of IEC 60191-2:1966/AMD15:2006



CENTER KEY CONFIGURATION
(VARIATION E02)

	DDR II SDRAM DIMM FAMILY 1,00 mm CONTACT CENTERS	Date:2006
	60191 IEC I-179E-a	